

成都高新发展股份有限公司

关于公司控股子公司转让资产一揽子交易暨关联交易的 进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

成都高新发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 11 日、12 月 29 日召开第九届董事会第八次临时会议、2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司控股子公司转让资产一揽子交易暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司成都高投芯未半导体有限公司（以下简称芯未公司）以非公开协议方式将持有的产线平台设备资产以 20,349.23 万元（含税价）转让给公司控股股东成都高新投资集团有限公司（以下简称高投集团）。本次资产转让完成后，高投集团委托芯未公司运营本次购买资产，开展中试业务，并租赁芯未公司持有的部分厂房（即一揽子交易），具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日、2025 年 12 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《成都高新发展股份有限公司关于公司控股子公司转让资产一揽子交易暨关联交易的公告》（公告编号：2025-46）、《成都高新发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-49）。

二、关联交易进展情况

根据芯未公司与高投集团已签署的《资产转让协议》《委托运营协议》《物业租赁协议》，截止本公告披露日，交易双方已按照前述协议约定完成本次转让资产的交割、委托运营资产移交以及租赁物业交付，本次资产转让交易已完成。近日，芯未公司已按协议约定收到高投集团支付的全部资产转让价款、预付租金及委托运营费合计 21,410.61 万元。公司敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

三、备查文件

- （一）转让资产交接表；
- （二）收款凭证。

特此公告。

成都高新发展股份有限公司董事会

2026年1月16日